

# 半导体产业融资扩产热潮 技术自主与全球竞争加速 科创引擎驱动新质生产力崛起

文 / 田也, 中国国际科技促进会半导体产业发展分会, 宣传部主任

**Semiconductor Industry Faces a Surge in Financing and Capacity Expansion Amid Accelerating Technological Autonomy and Global Competition**

**Innovation-Driven Engines Propel the Rise of New-Quality Productivity**

By Tian Ye, Director of the Propaganda Department of the Development Of Semiconductor Industrial Branch of the China International Association for Promotion of Science and Technology

本期《商机快报》聚焦全球半导体产业最新动态，呈现出一幅技术自主、资本密集与市场拓展交织的蓬勃图景。紫光展锐正式完成科创板 IPO 辅导备案，拟将募资重点投向 5G/6G 研发与全球化布局；摩尔线程、上海超硅、屹唐股份等企业也纷纷冲刺科创板，募资规模超百亿元。

上半年我国集成电路出口数量同比增长 20.6%，创历史新高，展现出中国在高科技产品领域的强劲竞争力与结构优化。在国际层面，德州仪器获美国政府支持斥资 60 亿美元扩产，Wolf speed 则因债务问题申请破产重组，凸显行业高投入、高风险的双重特性。

全球竞争，中国企业正通过技术创新与资本运作，加速推动新质生产力的落地与国际化突破。

**Abstract**

This issue of Business Opportunity Express focuses on the latest developments in the global semiconductor industry, presenting a dynamic landscape characterized by the interplay of technological autonomy, capital intensity, and market expansion. UNISOC has officially completed IPO guidance filing on the STAR Market, planning to direct its fundraising primarily toward 5G/6G R&D and global expansion. Other companies, including Moore Threads, Shanghai Advanced Silicon, and E-Town Semiconductor, are also pursuing listings on the STAR Market, with fundraising targets exceeding RMB 10 billion.

In the first half of the year, China's integrated circuit

exports increased by 20.6% year-on-year, reaching a historical high and demonstrating the country's strong competitiveness and structural optimization in the high-tech sector. On the international front, Texas Instruments received U.S. government support to invest USD 6 billion in capacity expansion, whereas Wolf speed filed for bankruptcy restructuring due to debt issues, highlighting the dual characteristics of high investment and high risk in the industry.

Amidst global competition, Chinese enterprises are accelerating the implementation of new-quality productivity and internationalization breakthroughs through technological innovation and strategic capital operations.

## 紫光展锐完成科创板上市辅导备案 募资将主要投向 5G/6G 研发等项目



来源：中国证券报

6月27日晚，中国证监会网上办事服务平台披露的信息显示，紫光展锐（上海）科技股份有限公司（以下简称“紫光展锐”）已在上海证监局完成首次公开发行股票（IPO）辅导备案工作，拟在科创板上市。

若成功登陆科创板，紫光展锐所募集资金将主要投向5G/6G 前沿技术研发、先进制程产能建设及全球化市场拓展。

紫光展锐此次完成 IPO 辅导备案建立在公司规范治理的基础之上。紫光展锐官网信息显示，紫光展锐于今年3月31日正式完成股改工商变更登记，公司名称由“紫光展锐（上海）科技有限公司”变更为“紫光展锐（上海）科技股份有限公司”。公司注册资本约55.32亿元，控股股东为北京紫光展讯投资管理有限公司（隶属于新紫光集团）。

作为国内集成电路设计领域领先的平台型芯片设计企业，

紫光展锐在移动通信与半导体领域深耕20余年，已全面掌握涵盖2G/3G/4G/5G/6G、Wi-Fi、蓝牙及卫星通信等全场景通信技术，特别是在5G通信、AIoT和物联网领域积淀深厚，并致力于持续推动前沿技术向新质生产力的转化。

紫光展锐的上市进程筹备已久。2024年，紫光展锐先后完成两轮大规模股权融资，为上市和业务发展注入强大动力；6月，获得超过40亿元的股权融资，投资方涵盖京沪两地国资平台，以及工银资本、交银金融资产投资、人保资本股权投资、中信建投、国泰君安、弘毅投资等众多金融机构；同年12月，再获近20亿元股权增资，由紫光展锐创始人、董事、首席战略顾问陈大同旗下的元禾璞华领投。这些资金主要用于5G、卫星通信、汽车电子、智能穿戴芯片等新产品的研发与迭代，以及创新技术的探索和人才吸引。

## 摩尔线程科创板 IPO 受理用于 AI/ 图形芯片等项目研发

6月30日晚间，上交所官网显示，摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司（以下简称“摩尔线程”）科创板 IPO 获得受理。

招股书显示，摩尔线程主要从事 GPU 及相关产品的研发、设计和销售。自2020年成立以来，公司以自主研发的全功能 GPU 为核心，致力于为 AI、数字孪生、科学计算等高性能

计算领域提供计算加速平台。

本次冲击上市，摩尔线程拟募集资金约80亿元，拟投资于摩尔线程新一代自主可控 AI 训推一体芯片研发项目、摩尔线程新一代自主可控图形芯片研发项目、摩尔线程新一代自主可控 AI SoC 芯片研发项目、补充流动资金。



来源：北京商报网

## 上海超硅科创板 IPO 进入问询阶段扩大 300 mm 薄层硅外延片产能等项目



来源：金融界

7月2日，上海超硅半导体股份有限公司（以下简称“上海超硅”）申请上交所科创板上市审核状态变更为“已问询”，长江证券为其保荐机构。

据招股书，本次 IPO 拟募集的 49.65 亿元资金，将主要用于三大项目：一是投资 29.65 亿元的集成电路用 300 毫米薄层硅外延片扩产项目，旨在扩大 300mm 薄层硅外延片产能，提升产品市场占有率；二是投入 10 亿元的高端半导体硅材料研发项目，聚焦于攻克高端半导体硅材料关键技术，推动产品升级；剩余 10 亿元将用于补充流动资金，以优化公司资金结构，

满足日常运营及业务拓展需求。

公开信息显示，上海超硅主要从事全球半导体市场需求最大的 300mm 和 200mm 半导体硅片的研发、生产、销售，同时公司还从事包括硅片再生以及硅棒后道加工等受托加工业务，已经发展为国际知名的半导体硅片厂商。公司拥有设计产能 70 万片 / 月的 300mm 半导体硅片生产线以及设计产能 40 万片 / 月的 200mm 半导体硅片生产线。公司产品已量产应用于先进制程芯片，包括 NANDFlash/DRAM(含 HBM)/NorFlash 等存储芯片、逻辑芯片等。

## 主要用于高端集成电路装备研发 屹唐股份募资达 24.97 亿元



来源：新华社客户端

7月8日，北京屹唐半导体科技股份有限公司（以下简称“屹唐股份”）于上海证券交易所科创板挂牌上市，由此迈入资本市场，进入全新阶段。

屹唐股份发行价格为 8.45 元 / 股，发行市盈率 51.55 倍，募集资金达 24.97 亿元人民币，主要用于集成电路装备研发制造服务中心

项目、高端集成电路装备研发项目及发展和科技储备资金。

屹唐股份成立于 2015 年，是面向全球经营的半导体设备公司。主要从事集成电路制造过程中所需晶圆加工设备的研发、生产和销售，面向全球集成电路制造厂商提供包括干法去胶设备、快速热处理设备、干法刻蚀设备在内的集成电路制造设备及配套工艺解决方案。

## 上半年我国集成电路出口数量增长 20.6% 创历史新高

7月14日，从海关总署获悉，2025年上半年，我国货物贸易进出口 21.79 万亿元人民币，同比增长 2.9%。其中，出口 13 万亿元，增长 7.2%；进口 8.79 万亿元，下降 2.7%。

2025年上半年，我国机电产品出口 7.8 万亿元，增长 9.5%，占出口总值的 60%，较去年同期提升 1.2 个百分点。其中，与“新质生产力”密切相关的高端装备增长超两成，代表绿色低碳的“新三样”产品增长 12.7%。

2025年上半年，我国出口机电产品 7.8 万亿元，增长 9.5%。其中，集成电路出口数量增长 20.6% 至 1677.7 亿个，出口金额增长 20.3% 至 6502.6 亿元。

2025年上半年，我国进口机电产品 3.4 万亿元，增长 6.3%。其中，集成电路数量增长 8.9% 至 2818.8 亿个，价值金额增长 8.3% 至 1.38 万亿元。

经梳理发现，今年以来，以集成电路、汽车、船舶等为代表的高新技术产品出口增速显著高于外贸整体增速。从更长时间跨度来看，去年下半年以来，尽管受到中美贸易摩擦等因素影响，多项高技术产品出口增速呈现先降后升的趋势，近期增长势头强劲。

商务部研究院原院长霍建国表示，这是产能扩大和竞争力提升同时作用的结果。两三年之前，拉动出口增速最快的产品是新能源汽车、光伏和锂电池等。去年以来，船舶、半导体以及和芯片相关的产品出口形成规模。“在全球 AI 产业互相追赶的时代，国际市场对半导体的需求处于上升阶段。”

“我国外贸的产品结构确实发生了很大变化，高科技产品处于强势发展阶段。”霍建国进一步表示，在美国出台加征关税政策的背景下，中国外贸企业通过高科技产品打开了市场，进一步拓展对东南亚、印度等新兴市场占有率。



来源：海关发布

## 用于芯片制造设施建设 德州仪器拟投资 60 亿美元

当地时间 6 月 18 日，德州仪器（Texas Instruments）在特朗普政府的施压下，宣布计划大幅提高国内芯片生产效率。该公司将投资 60 亿美元，在德州和犹他州的三个地点建设或扩展七个芯片制造设施，包括德州谢尔曼的两个新设施。德州仪器一直在德州和犹他州建设设施，以增强内部制造能力，并应对来自中国模拟芯片制造商的竞争。

这是《CHIPS 与科学法案》中的一部分，去年拜登政府同意提供 16.1 亿美元的政府补贴，支持德州仪器在三个新设施的建设，前提是公司承诺至少投资 180 亿美元。德州仪器总裁兼 CEO Haviv Ilan 表示，公司正在大规模建设可靠、低成本的 300 毫米产能，以满足几乎所有类型电子系统对模拟和嵌入式处理芯片的需求。苹果、福特、美敦力、英伟达和 SpaceX 等美国领先企业依赖德州仪器的世界级技术和制造专业知识。

此投资被誉为“美国历史上最大的基础半导体制造投资”，有望创造超过 6 万个新工作岗位。



来源：中国科学院知识服务平台

## 拟获得 2.75 亿美元新融资 半导体巨头 Wolfspeed 破产重组



6 月 23 日，美国第三代半导体巨头、曾经一度占据 60% 以上市场份额的 Wolfspeed 正式宣布计划向法院申请破产保护，以进行债务重组。

根据最新披露的破产重组协议，Wolfspeed 的总债务在重组前为 65 亿美元。作为与债权人达成的一项重组协议的一部分，Wolfspeed 计划通过破产重组获得 2.75 亿美元的新融资并削减约 70% 的债务（约 46 亿美元）来缓解其财务压力。公司的主要债权人主要包括美国资产管理投资公司 Apollo Global Management、日本 MCU 芯片巨头瑞萨电子。

公司表示，其目前的现金流约 13 亿美元，足以在重组期间维持正常运营，且不会中断对客户的服务或对员工的薪酬和福利。



来源：界面新闻网